

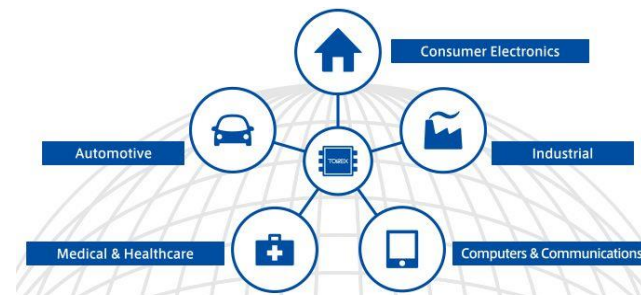
2020年3月期 決算説明資料

2020年5月21日

トレックス・セミコンダクター株式会社

世界は「アナログ」でできている

あらゆるフィールドで活躍するトレックスの電源IC



1

2020年3月期 業績

2

2021年3月期 業績予想

3

株主還元

Appendix

▶ **トレックス・フェニテックともに車載分野は堅調に推移するも、産業機器が大幅に減少し、前年同期比減収**

▶ **売上高が減少する中、減価償却費等の費用増の影響により、前年同期比減益**

▶ **対業績予想は、トレックスにおいて新型コロナの影響による中国の出荷遅延やフェニテック鹿児島工場の設備導入の遅延により、売上が想定以下に留まったこと等で未達**

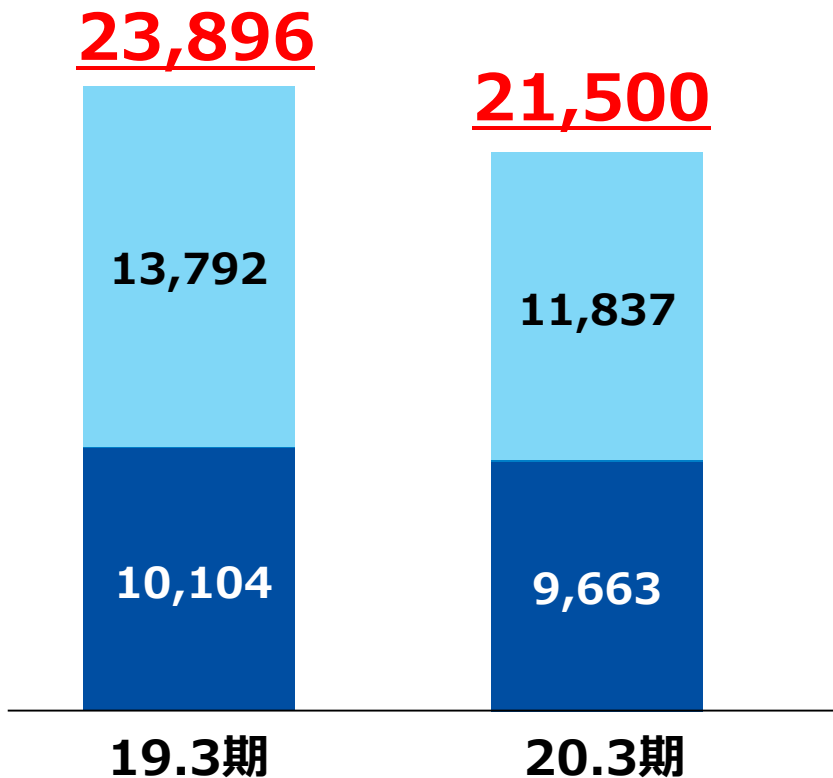
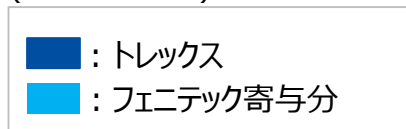
2020年3月期 業績

(単位：百万円)

科目	19.3期通期 実績	20.3期通期 実績	対前年同期比 増減率	20.3期通期 修正予想	対修正予想比 増減率
売上高	23,896	21,500	▲10.0%	22,000	▲2.3%
営業利益	1,550	678	▲56.3%	850	▲20.2%
営業利益率	6.5%	3.2%	▲3.3Pt	3.8%	▲0.6Pt
経常利益	1,820	676	▲62.8%	800	▲15.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,049	417	▲60.2%	550	▲24.1%
EPS（円）	95.70	37.97	▲60.3%	50.47	▲24.1%
海外売上高比率（*1）	71.8%	67.2%	▲4.6Pt	-	-
平均為替レート（1\$=）	¥110.7	¥109.1	-	¥108.0	-
減価償却費	1,085	1,312	20.9%	1,532	▲14.4%
設備投資	3,323	1,497	▲55.0%	1,651	▲9.3%

(*1)海外売上高比率：外貨建て売上比率

(単位：百万円)



➤ トレックス

- 米中貿易摩擦の影響等により、アジア以外の地域が低調
- 車載分野は中国・日本で好調

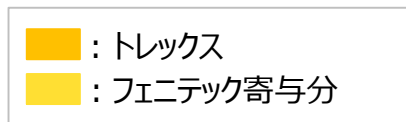
➤ フェニテック

- 北米・中華圏が減少したものの4Qに前年同期比増収に転換
- 車載分野は堅調

(単位：百万円)

	19.3期 実績	20.3期 実績	対前年同期比増減率
売上高	23,896	21,500	▲10.0%

(単位：百万円)

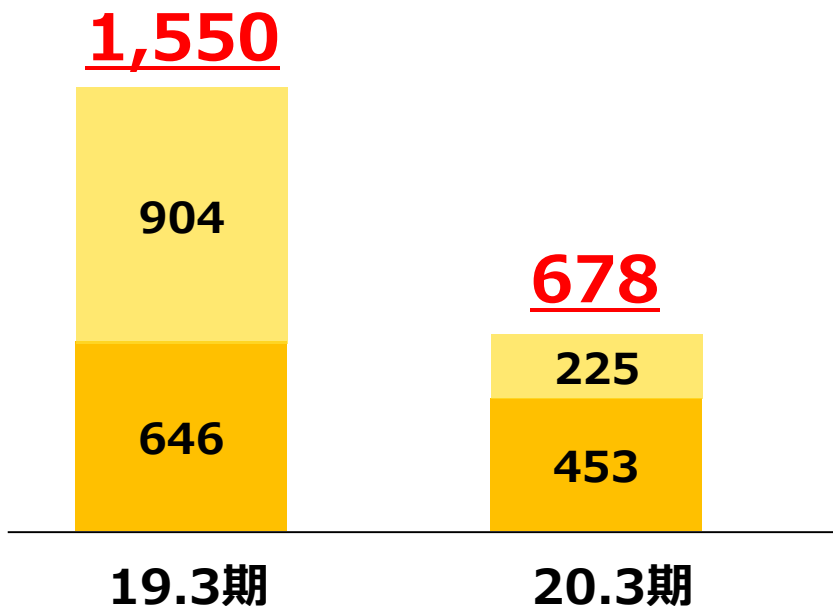


➤ トレックス

- 販管費等の費用削減につとめるも
売上の減少を補えず、減益

➤ フェニテック

- 受注減少による稼働率低下
- 工場統合に伴う減価償却費の増加

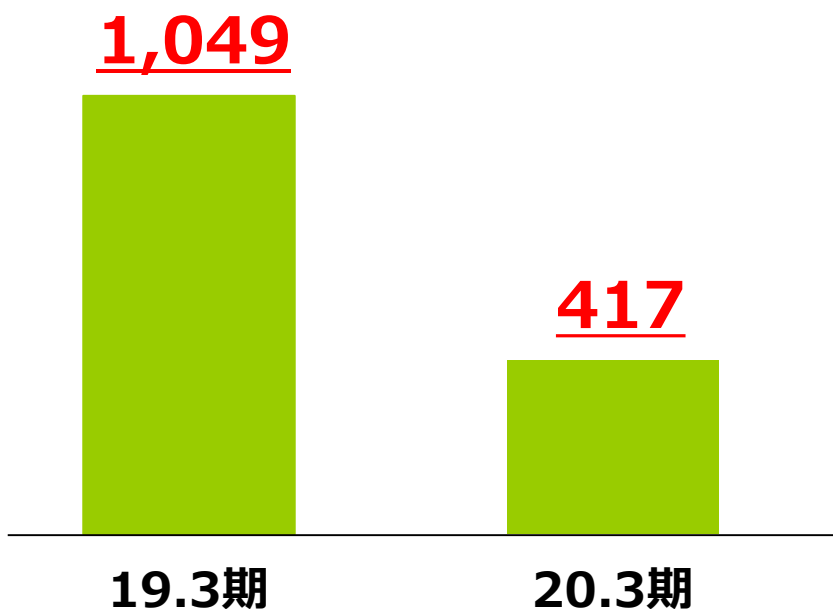


(単位：百万円)

	19.3期 実績	20.3期 実績	対前年同期比増減率
営業利益	1,550	678	▲56.3%

(単位：百万円)

営業利益の大幅な減少に加え、前年度発生した為替差益の反動減等の影響により、各段階利益が減少し、減益



(単位：百万円)

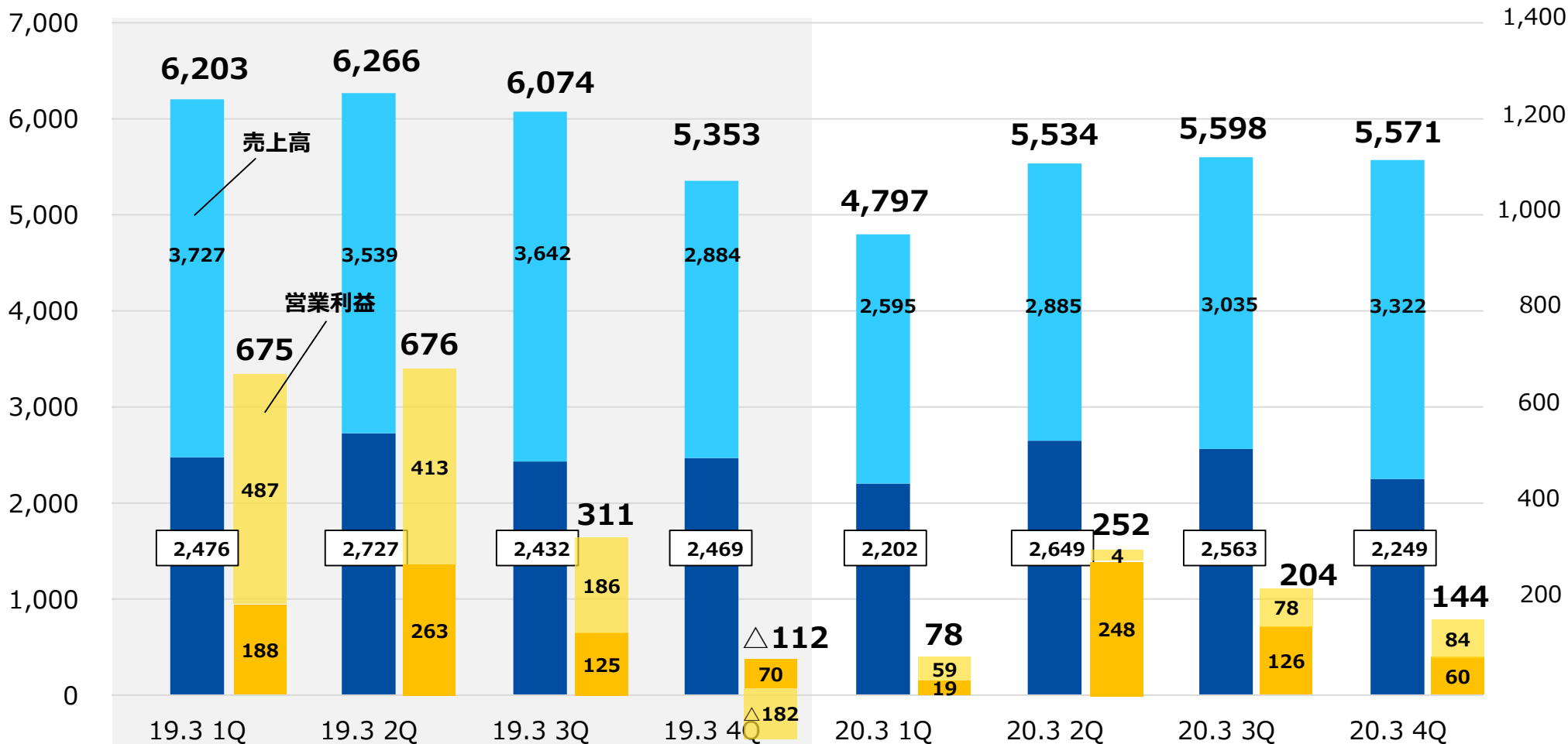
	19.3期 実績	20.3期 実績	対前年同期比増減率
当期純利益	1,049	417	▲60.2%

フェニテック : ■ ■
 トレックス : ■ ■

(左軸：売上高)
 (単位：百万円)

(右軸：営業利益)
 (単位：百万円)

売上高・営業利益の四半期推移



(単位：百万円)

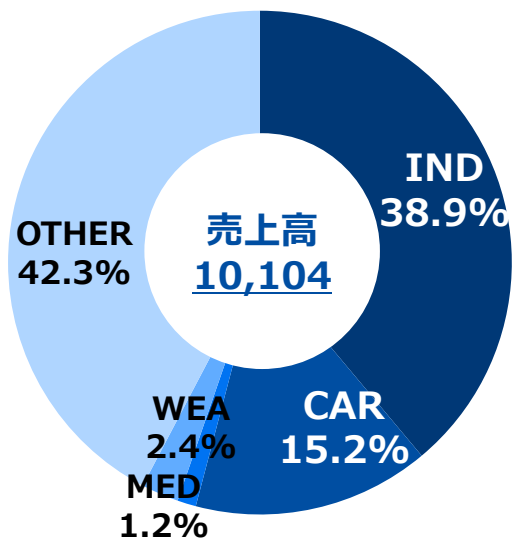
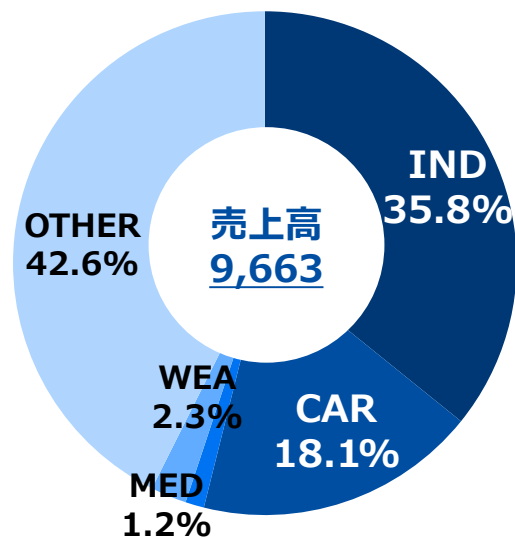
科目	19年3月期末	20年3月期末	対前期末増減
資産	28,385	27,846	▲539
負債	8,747	9,175	428
純資産	19,638	18,671	▲967

<参考> キャッシュ・フロー関連指標の推移

科目	19年3月期末	20年3月期末	対前期末増減
有利子負債	4,716	4,748	32
自己資本比率	69.0%	67.1%	▲1.9pt
D/Eレシオ	0.24	0.25	0.01

トレックス／フェニテック 各単体

TOIREX

19.3期実績20.3期実績

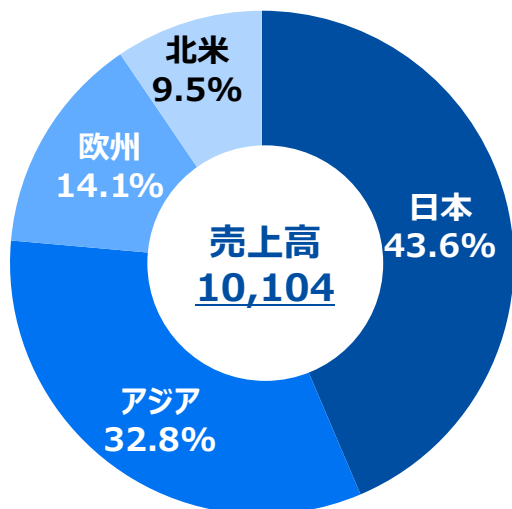
(単位：百万円)

アプリケーション		19.3期		20.3期		対前年同期比 増減率
		売上高	構成比	売上高	構成比	
IND	産業機器	3,927	38.9%	3,463	35.8%	▲11.8%
CAR	車載機器	1,535	15.2%	1,749	18.1%	▲13.9%
MED	医療機器	125	1.2%	118	1.2%	▲5.6%
WEA	ウェアラブル機器	238	2.4%	220	2.3%	▲7.6%
OTHER	その他機器	4,279	42.3%	4,113	42.6%	▲3.9%

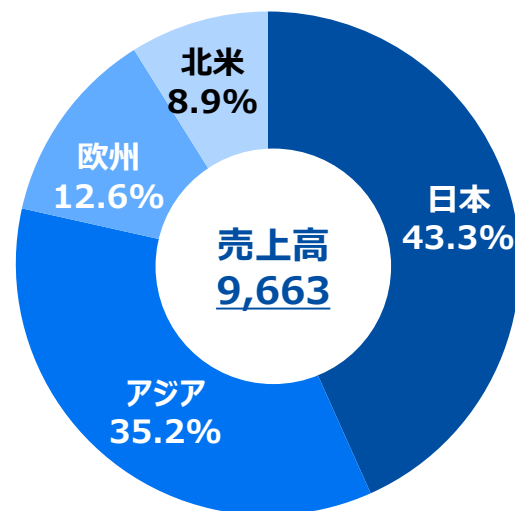
※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。

2020年3月期 ～地域別売上高（トレックス）

TOIREX



19.3期実績

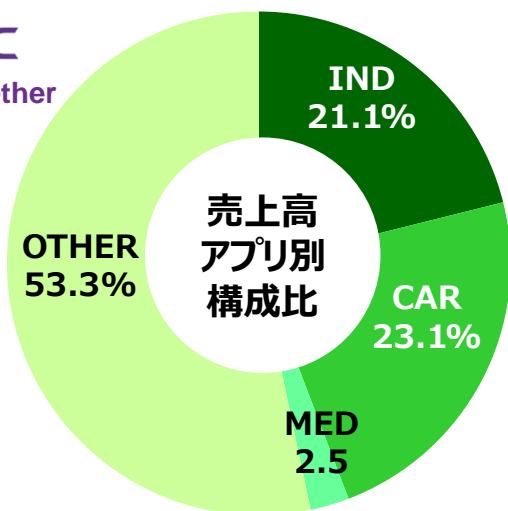


20.3期実績

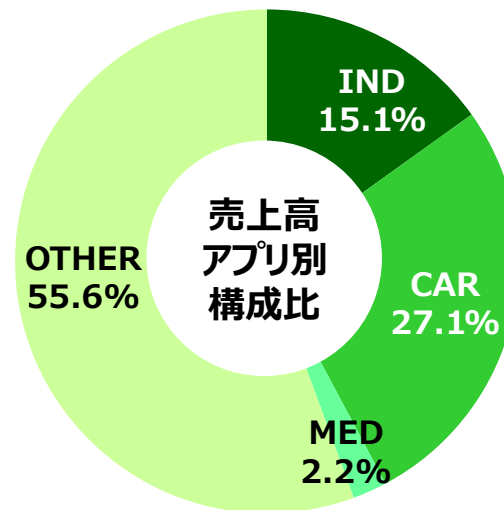
(単位：百万円)

地域 (D-in)	19.3期		20.3期		対前年同期比 増減率
	D-in 売上高	構成比	D-in 売上高	構成比	
日本	4,401	43.6%	4,187	43.3%	▲4.9%
アジア	3,312	32.8%	3,405	35.2%	2.8%
欧州	1,430	14.1%	1,212	12.6%	▲15.2%
北米	961	9.5%	859	8.9%	▲10.6%
平均為替レート (1\$=)	110.7円		109.1円		-

D-in 売上高：デザイン・イン・ベース売上高。当社の製品を搭載した製品が企画・設計され、実質的に受注を獲得した地域をベースとした売上高



19.3期実績



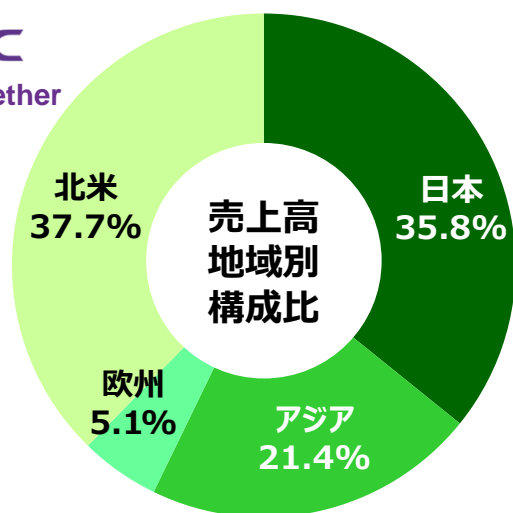
20.3期実績

(単位：百万円)

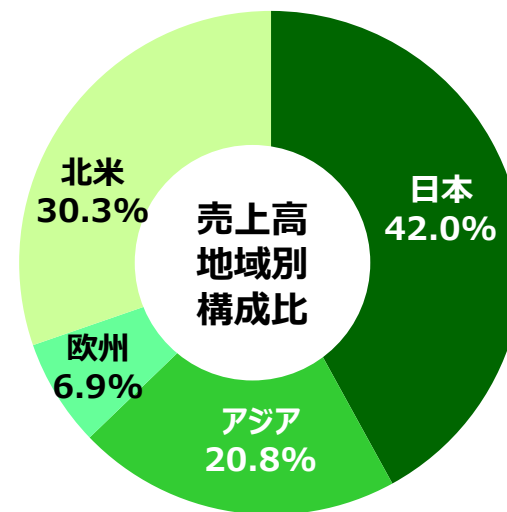
アプリケーション	19.3期		20.3期		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
IND 産業機器	3,262	21.1%	2,009	15.1%	▲38.4%
CAR 車載機器	3,560	23.1%	3,604	27.1%	1.2%
MED 医療機器	390	2.5%	288	2.2%	▲26.2%
OTHER その他機器	8,240	53.3%	7,396	55.6%	▲10.2%

※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。
トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む

2020年3月期 ～地域別売上高（フェニテック）



19.3期実績



20.3期実績

※ 顧客の所在地別に区分しています。

(単位：百万円)

地域（顧客）	19.3期		20.3期		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
日本	5,529	35.8%	5,586	42.0%	1.0%
アジア	3,306	21.4%	2,764	20.8%	▲16.4%
欧州	789	5.1%	920	6.9%	16.6%
北米	5,828	37.7%	4,027	30.3%	▲30.9%
平均為替レート（1\$=）	110.7円		109.1円		

※注：日本には、トックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む

トレックス

- ・産業機器は、主に監視カメラ向け、衛星通信向け、FA関連向けが低調
- ・車載機器は、中国のETC向け、日本のドライブレコーダー向けが好調
- ・その他の民生機器は、全般的に低調な中、PC用のCMOSカメラモジュール向け等は好調

フェニテック

- ・産業機器は、北米の大口顧客向けが大幅に減少（徐々に回復基調）
- ・車載機器は、日本向けが堅調に推移
- ・その他の民生機器は、中華圏向けが減少（徐々に回復基調）

2021年3月期 業績予想

2021年3月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による当社グループの業績にあたる影響が不透明であることから、現時点では未定としております。

今後、業績予想の合理的な算定が可能となった時点で開示させていただきます。

	トレックス	フェニテック
生産	<p>前工程は、影響なし。 中国の後工程委託会社の稼働が一時的に低下するも、現状はほぼ回復。</p>	<p>岡山工場・鹿児島工場ともに稼働状況に影響なし。</p>
販売	<p>前年度4Qは、中国の春節延長による出荷遅延や期末の短納期受注の減少による影響あり。 今年度に入り、ロックダウンや外出自粛による経済活動停滞の影響で、受注は減少傾向を予想するも、先行きは不透明。</p>	<p>車載分野で受注の減少傾向が見られるも、海外顧客を中心に現時点では大きな影響はでていない。 先行きに関しては、不透明であり、注視が必要。</p>

新型コロナウイルスの感染拡大による現時点までの事業への影響は、トレックス、フェニテック共に生産面、販売面（受注状況）で大きな増加や減少といった影響は見受けられておらず、限定的でありました。しかしながら、政府による緊急事態宣言の発令等を受け、当社では、従業員の感染症対策としてテレワークや時差出勤などを徹底して講ずるなど、事業活動にも一定の制約を受けております。また、ロックダウンや外出自粛による世界的な経済活動停滞が、今後事業へ影響を与える可能性も考えられるため、引き続き、景気動向に与える影響や当社業績への影響について注視してまいります。

フェニテックも新型コロナウイルス発生行動計画を作成し、感染機会の抑制および従業員の安全確保のため全従業員に対し社内感染防止策について徹底するとともに、臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援として特別休暇措置の実施や在宅勤務の実施を行ってきました。また出張規制、来客対応についても行動計画に準拠して対応しております。

2021年3月期 経営方針

市場の変化に対応

生き残るために 変革とチャレンジ！

「強み」の再認識、再構築、強力発信

■ファブレス 電源IC専門メーカーの強み

⇒ 外部工場と内製工場の両立、パワーディスクリート製品用ファウンドリ

⇒ 超低消費・小型・低ノイズ製品、コイル一体型DC/DCコンバータ、最適回路提案

■ターゲット市場・顧客で認められる「強み」の分かりやすい発信

■同業他社との協業関係の推進

「強み」①：投資額を抑えつつ、新技術に早期対応が可能

ファブレス型事業形態を維持しつつ、製造パートナーをグループ内に取り込み、製造工程の自社所有とファブレスのメリットを併せ持つ生産体制

	Quality	Cost		Delivery	
	製造技術 / 品質	原価	投資額	納期	新規技術 対応期間
自社所有	○	△	×	○	×
ファブレス	△	○	○	△	○

前工程（ウエハプロセス）

- ・フェニテックセミコンダクター 完全子会社
トレックス製品は10%程度
- ・ファウンダリ
国内外で4社利用

後工程（アセンブリ）

- ・トレックス ベトナム工場 完全子会社
トレックス製品のみ生産
- ・協力アセンブリ会社
パッケージ種類により選定
国内外で複数社利用

高付加価値製品を長期安定供給できる企業へ

「強み」②：電源ICに特化した、技術の蓄積による市場への製品対応

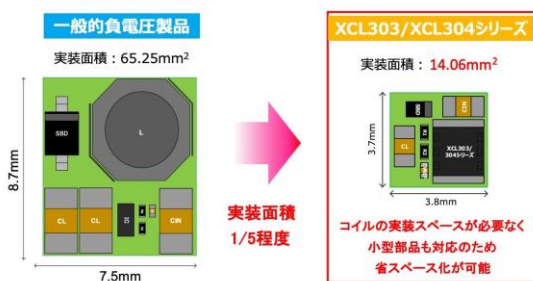
「小型」、「低消費電流」、「高効率」、「低ノイズ」のキーワードを徹底して追求してきた技術の蓄積に支えられた、製品企画と製品開発

新製品開発例：コイル一体型 負電圧出力 DC/DCコンバータ **XCL303/304シリーズ**
 ターゲット用途：光通信トランシーバー（5Gなどの高速通信に必須の光ケーブル向け）

XCL303/XCL304が光通信トランシーバーに最適な理由

TOIREX

他社製品との実装面積比較



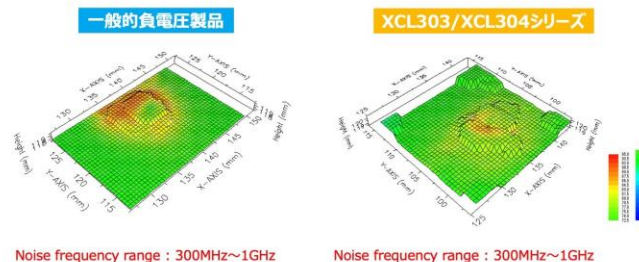
他社製品、負電圧DCDCに比べ
コイル一体型により小実装面積を実現

XCL303/XCL304が光通信トランシーバーに最適な理由

TOIREX

他社製品との近傍磁界比較

Test condition : VIN=3.3V, VOUT=-5.0V, IOU=100mA, Recommended external components



他社製品、負電圧のDCDCに比べ
近傍磁界ノイズが小さいので、光通信レート低下が起こり難い

- 小型**：コイル一体化技術で小型化、実装面積従来比で **78%削減**
- 低消費電流**：軽負荷時にPFM自動切換えで低消費電流
- 高効率**：PWM/PWM自動切換えで、幅広い電流負荷範囲で**高効率70%以上**を達成
- 低ノイズ**：ポケットコイルタイプのコイル一体型を採用で、近傍磁界ノイズが小さい

コイル一体型DC/DCコンバータ (micro DC/DC) ターゲット市場

一般民生品分野

- ・フルワイヤレス イヤホン
- ・オーディオ機器
- ・ウェアラブル機器
- ・美容製品
- ・BT、WiFi、GPS モジュール

産業機器分野

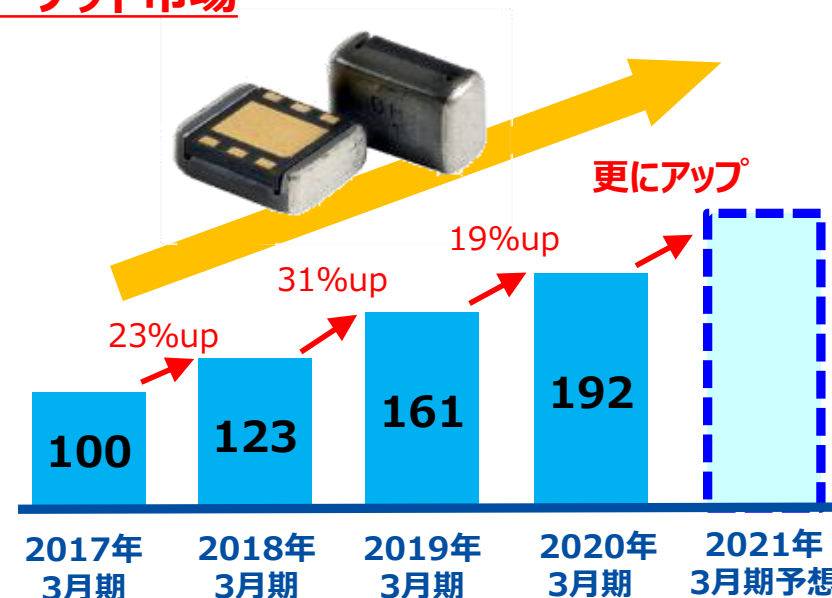
- ・5G 光通信トランシバー
- ・マイコン制御基板
- ・各種センサーモジュール
- ・カメラモジュール
- ・ホームセキュリティ
- ・POS端末
- ・IoTデバイス モジュール

医療・ヘルスケア分野

- ・血圧計
- ・血糖値計
- ・血液酸素濃度計
- ・ヘルスケア用品

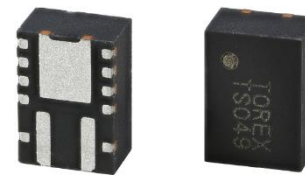
車載機器分野

- ・ドライブレコーダー
- ・ETC
- ・カーナビ
- ・カーオーディオ
- ・キーレスエントリー
- ・車載カメラ
- ・パワーウィンドウ
- ・ヘッドアップディスプレイ
- ・パワースライドドア
- ・サブディスプレイ



コイル一体型DC/DCの売上推移 (2017年3月期を100とする)

はんだフリットが確認できる、車載専用パッケージをコイル一体型製品に追加



ウェットプルフラック構造 パッケージ
DFN3625-11B (2.5x3.6x1.55mm)

「強み」③：同業他社との協業を積極的に取り入れた新分野への参入

関連業者や同業他社との技術協力と協業を大切にし、また積極的に取り組み、新たなビジネスチャンス
を常に探索し実行する姿勢

たとえば、以下の事を行っております。

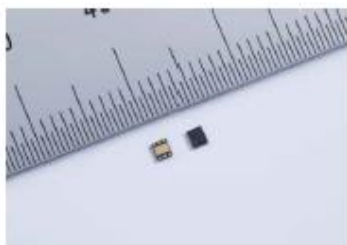
- ・ インド Cirel社との開発業務提携による、開発リソースの強化
- ・ MATRIX Industries社とのエネルギーハーベスト分野でのアライアンスによる、市場探索
- ・ 日本ガイシ社との「EnerCera電池ソリューション」の展示会共同出展による、ソリューション拡販

IoT/Wearable/Medical, SmartCard向け 小型高性能電池 + 電源ICソリューション

TOIREX

超小型、低消費電流の電源IC

- Li充電に適したCharger ICとLDO
- 100nAクラスの消費電流を実現したリセットIC
- 超小型、低EMIを実現するコイル一体型“micro DC/DC”
- Smartcardに適した高さ0.33mm(max)のUSP/WLPパッケージ



日本ガイシ NGK

EnerCera電池

- 小型、薄型かつ、高温実装が可能なLi2次電池
- LDOにて充電可能なタイプを用意
- Coinタイプはリフロー対応
- Pouchタイプはホットラミネーション対応

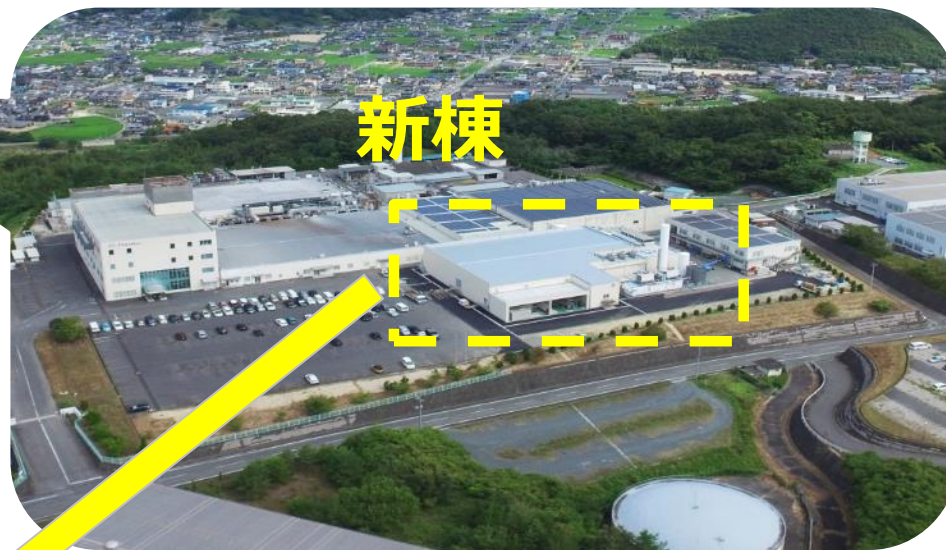


当社の「強み」は、「ファブレス会社の 身軽さ」と「自社工場の柔軟性」の良いところを合わせ持っている点だと考えています。工場管理に係る固定費や設備投資を抑え、半導体プロセス開発にかかる期間を最小にしつつ、新しい技術や製品をタイムリーに市場へ提供できる「ファブレス」を企業運営の基本としますが、BCP（ビジネスの継続性の担保）や短納期対応、品質管理などは、完全子会社であるフェニテックセミコンダクターやベトナム工場を利用し、市場や顧客の要求に柔軟に対応できる環境も備えております。それぞれの「良いとこ取り」が行えるのが最大の強みになってます。

その中で、当社の強みが凝縮した製品に、コイル一体型DC/DCコンバータ “micro DC/DCコンバータ”があります。この技術は今後のDC/DCコンバータの主流になりますので、当社は新製品開発に非常に力を入れており、既に30品種以上の製品をリリースしており、毎年10%以上の売上増加があります。micro DC/DCコンバータの開発におきましても、低消費・小型・低ノイズだけでなく、通信系であれば低ノイズに加え不要ノイズの低減や、車載向製品ではウェットブルフランク構造など、採用されるアプリケーションの仕様や要求に応じた製品開発行っています。

また当社では、電源ICは何処にでもビジネスチャンスがあると考えています。いち早く情報をキャッチするため、関連する会社はもちろん、同業他社との協業も大切な機会だと考え、積極的に協業に取り組んでいます。中長期的に半導体需要は産業機器や車載機器向けに拡大していくことが予想されており、設計開発のリソースの確保を行うとともに、新たな市場を探查することや、新たなソリューションを提供することを積極的に行い、拡大する市場にしっかりと対応していきたいと考えてます。

本社工場の第一工場への統合①



新棟 (Fab4)



増床エリア



本社工場を第一工場へ統合

既存棟増床



試作製品流動は、計画通り進捗中



新棟建設



2018年8月27日
落成

量産用設備移動



お客様の承認を受け、順次量産移管



一部顧客承認済 9月より量産開始

移設完了予定

2018年度

2019年度

2020年度

統合効果

- ・ 製品の長期安定供給体制の継続
- ・ 5インチ → 6インチ化による 生産効率向上 (6インチ比率：統合前 24% ⇒ 統合後 64%)
- ・ 適切な装置とレイアウトによる 生産効率向上
- ・ 省エネルギー構造の工場による 製造コストの低減
- ・ 車載・産業機器向け品質の維持/向上
- ・ 新棟で本社工場の特徴である金、白金などの重金属加工工程を保有

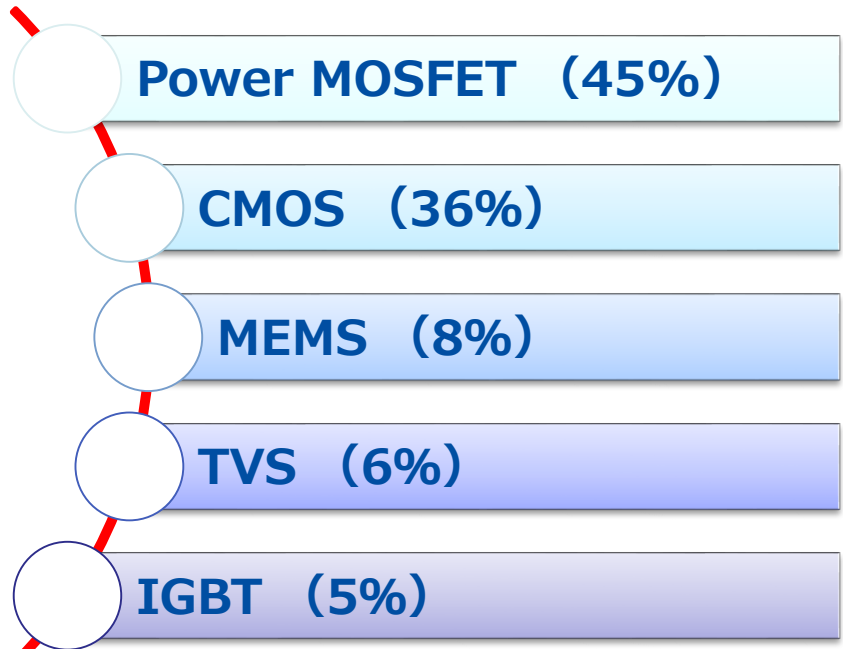
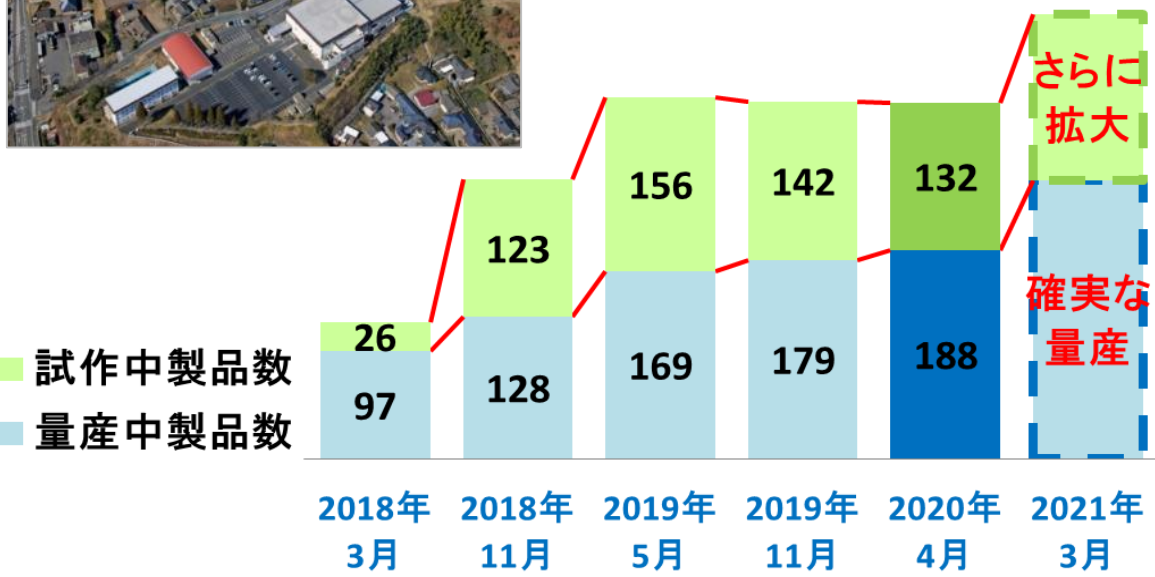
生産性向上
製造コスト低減
高収益体制の構築

鹿児島工場の特長

- **6インチ** / 0.18 μ mの加工、化合物半導体 SiC デバイス開発
 - 第一工場(岡山)プロセスと類似装置
 - 2020年 IATF16949取得予定
- BCP対応 (地震・降灰・停電)**
車載製品対応



2020年度 通期 利益貢献見込み



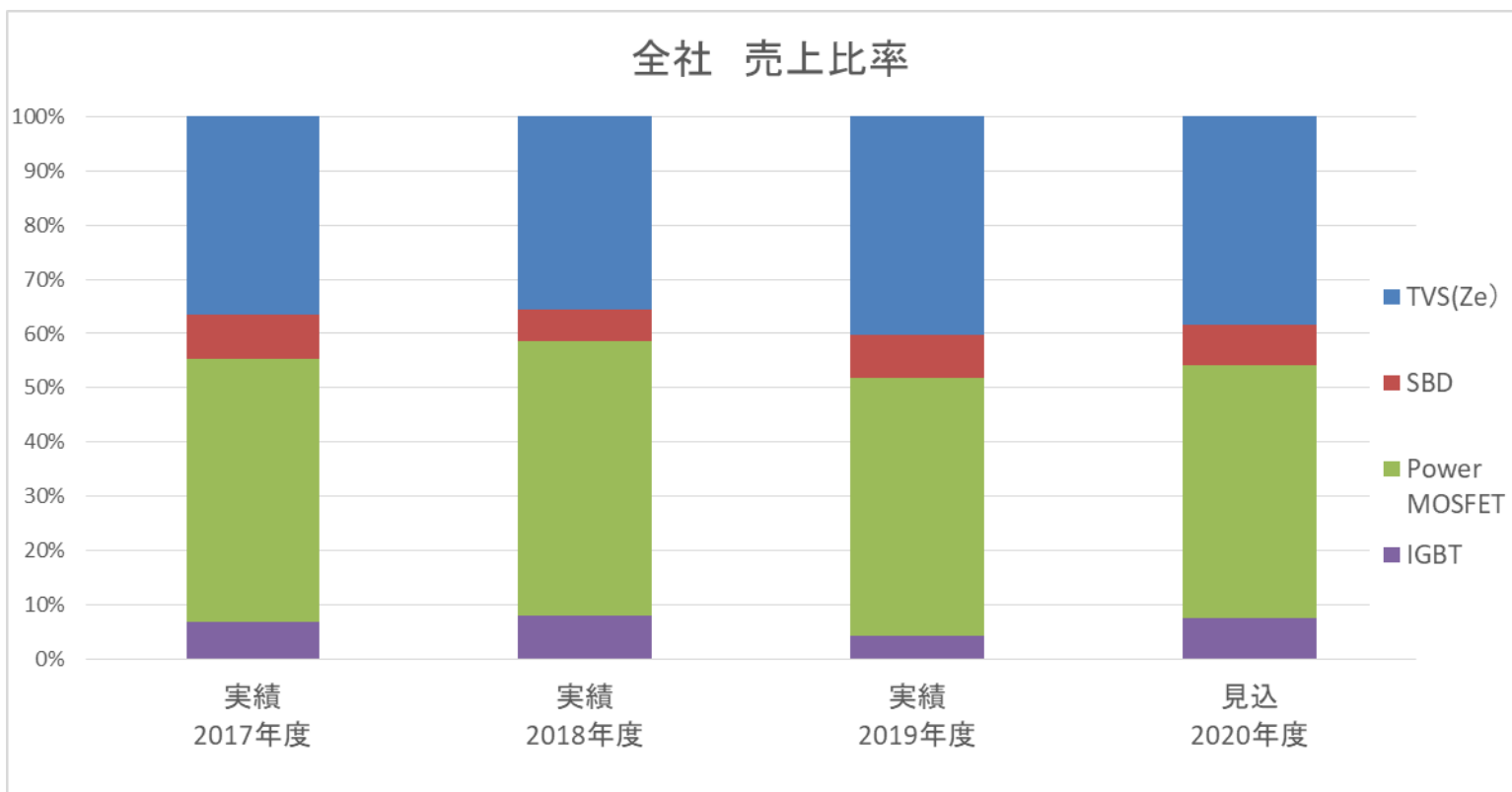
主な量産製品と構成比

■ パワー半導体を中心に生産・新規引き合いが好調

要因： 自動車の電装・電動化、省エネ（インバーター化）

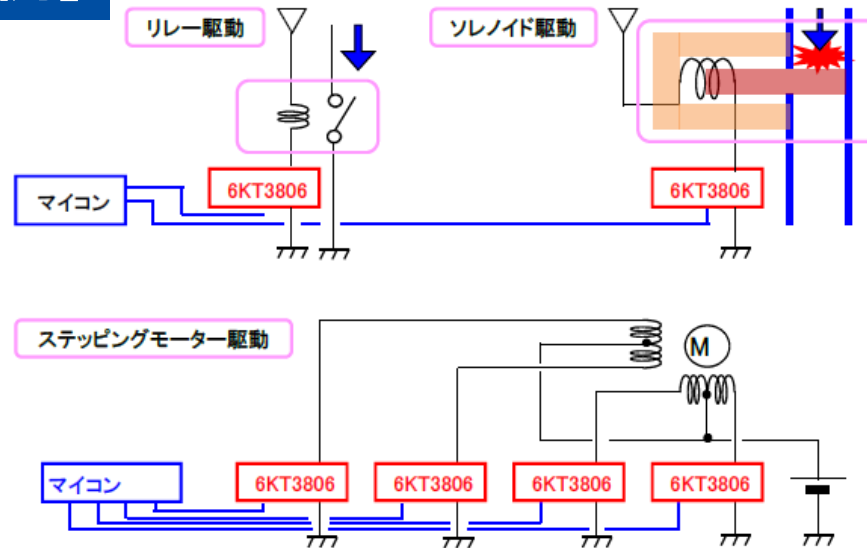
デバイス： IGBT、Power MOSFET、SBD、TVS

新デバイス： SiCデバイス（SBD、MOSFET）、GaN、Ga₂O₃



リレー・ソレノイド・ステッピングモーター等の誘導性負荷の駆動に最適な アクティブクランプ構造のMOSFET（6KT3806）を開発

【用途例】



【特長】

- バイアス抵抗内蔵の為、周辺部品削減が可能
- マイコンから直接、駆動することが出来る
- 静電破壊防止用保護ダイオード内蔵
- 回路レイアウトがシンプルになり、実装の省スペース化に寄与

鹿児島工場6インチにて 価格競争力のある SiC SBD（ショットキーバリアダイオード）を開発中



更なる低価格化へ向け、産総研が発起人の「つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション（TPEC）」に Associate Memberとして参加し、SiC MOSFETを研究開発中

■ SiCデバイス製造に特有な装置を導入済



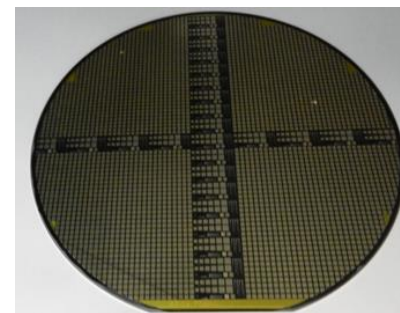
高温イオン注入機



SiCドライエッチング装置



活性化アニール装置



低価格で高品質なSiCデバイスの自社生産を行う。

2020年度量産開始に向け準備中

本社工場から第一工場への移転は、現在、試作・生産ラインは確立し、計画に従って量産の拡充に向けて取り組んでいます。工場統合のスケジュールは、新型コロナウイルスの影響や追加サンプル要求などあり一部の顧客承認に遅れが生じておりますが、計画通り、一部で量産をスタートしています。今後も顧客承認手続きを進め、今年度中には統合計画を完結させる予定です。

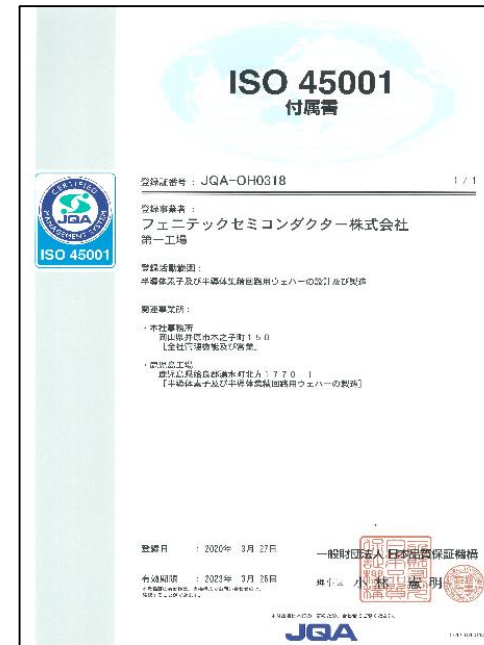
鹿児島工場は、CMOS製品及び従来のIGBT、PowerMOSFETの受注は順調で、計画した顧客の試作は順次、量産へ移行されています。生産枚数はPowerMOSFETが多いですが、生産数増加に伴い、利益アップを図るため、岡山工場との製品ミックスを検証し生産拠点の最適化を進めています。また、2020年3月期の目標の一つであった単月での利益貢献も達成でき、今後は当社の収益向上に大きく貢献してくれるものと期待しております。

フェニテックは、ディスクリートのファンドリーを主な業務としており、最近では特に、車載用や産業機器向けのPowerデバイス（MOSFET、IGBT、TVSなど）の生産を手掛けています。また、次世代のPowerデバイスと言われるSiCさらにはGaN、さらにGa2O3など化合物半導体も手掛けています。

フェニテックでは、オリジナル製品の開発も積極的に取り組んでおり、その一つで、Siを用いたアクティブクランプMOSFETの開発が完了しました。リレー・ソレノイド・ステッピングモーター等の誘導性負荷の駆動に最適なデバイスとなっております。今後の収益増加の一つとして拡販に向けて取り組んでいきます。

2010年ごろから始めたSiC SBDデバイス開発も最終段階にあり、現在はコスト低減策を盛り込み鹿児島工場の6インチにて立ち上げ中であり計画通り進めています。650V及び1200Vの今期量産開始を目指しております。

労働安全衛生の国際規格 ISO45001 2020年3月21日取得



フェニテックでは、環境保護と労働安全衛生を一体化した総合マネジメント体制のもと、安全衛生マネジメントシステムの国際規格であるISO45001認証を2020年3月27日に取得いたしました。

今後は、要求事項に従い、働く人の労働に関係する負傷及び疾病を防止すること、及び安全で健康的な職場を提供することを目的とし、効果的な予防保護処置をとることによって危険源を除去し、労働安全衛生リスクを低減することを目指して取り組んでいきます。この取組は「働き方改革」を推進する上でも有効活用できるものであり、メンタルヘルスや過重労働対策等の健康確保への取り組みの計画的な実施を行っていきます。

株主還元

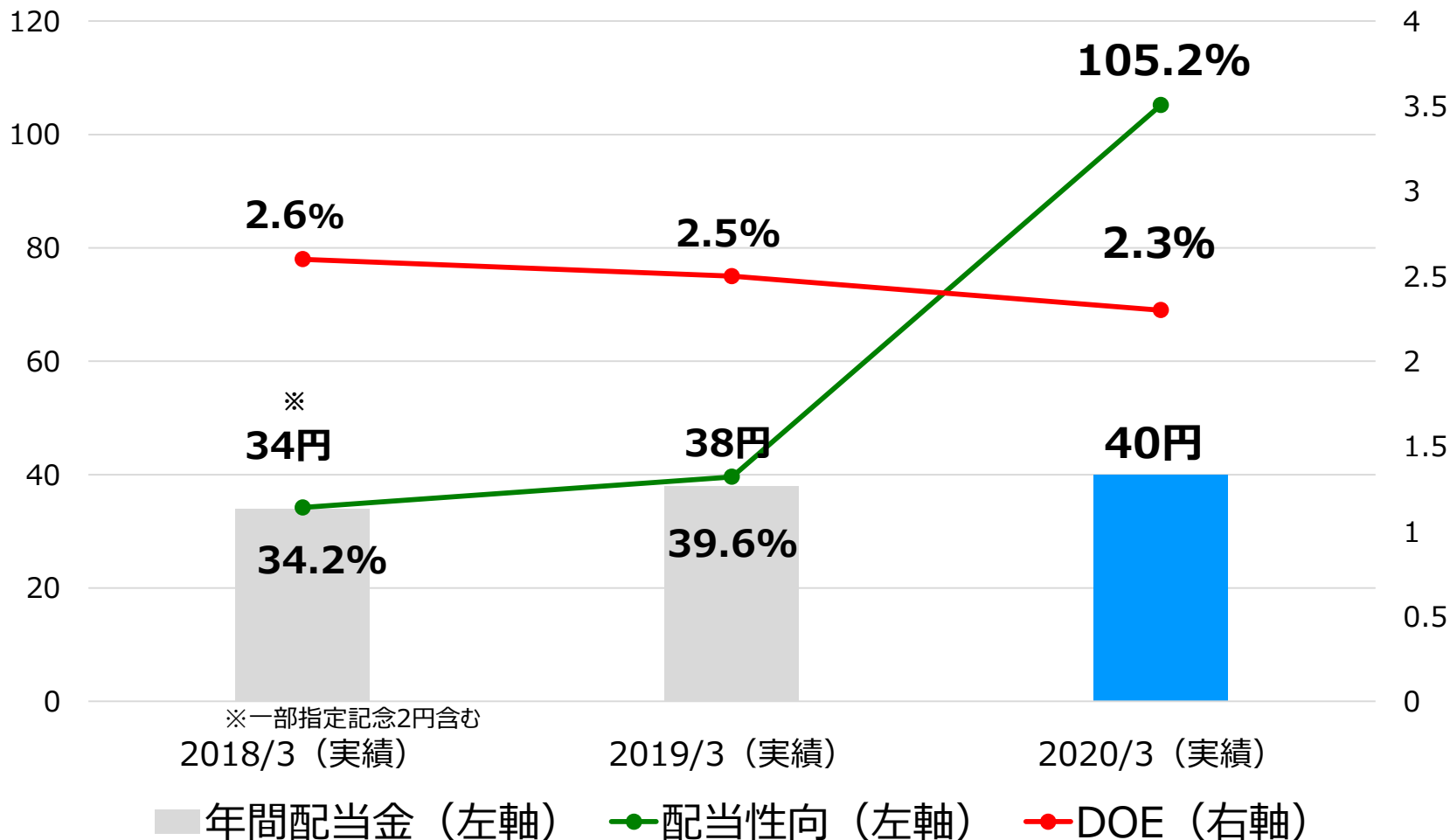
戦略的投資による成長力の向上を図りつつ、当社を取り巻く経営環境並びに中長期の連結業績及び株主資本利益率の水準を踏まえて実施していくことといたします。

配当につきましては、業績水準を反映した利益配分として**連結配当性向20%以上**、安定的かつ継続的な株主還元
の拡充として**株主資本配当率（D O E）3%程度**を当面の目標として実施してまいります。

2021年3月期の配当は、現時点では未定とさせていただきます

配当金：円
配当性向：%

DOE：%



Appendix 会社紹介

2014年4月にJASDAQスタンダード市場に上場、2015年10月に東証二部に市場変更し、2018年3月に東証一部指定となった、創業25年の半導体メーカーです。

アナログのチカラ

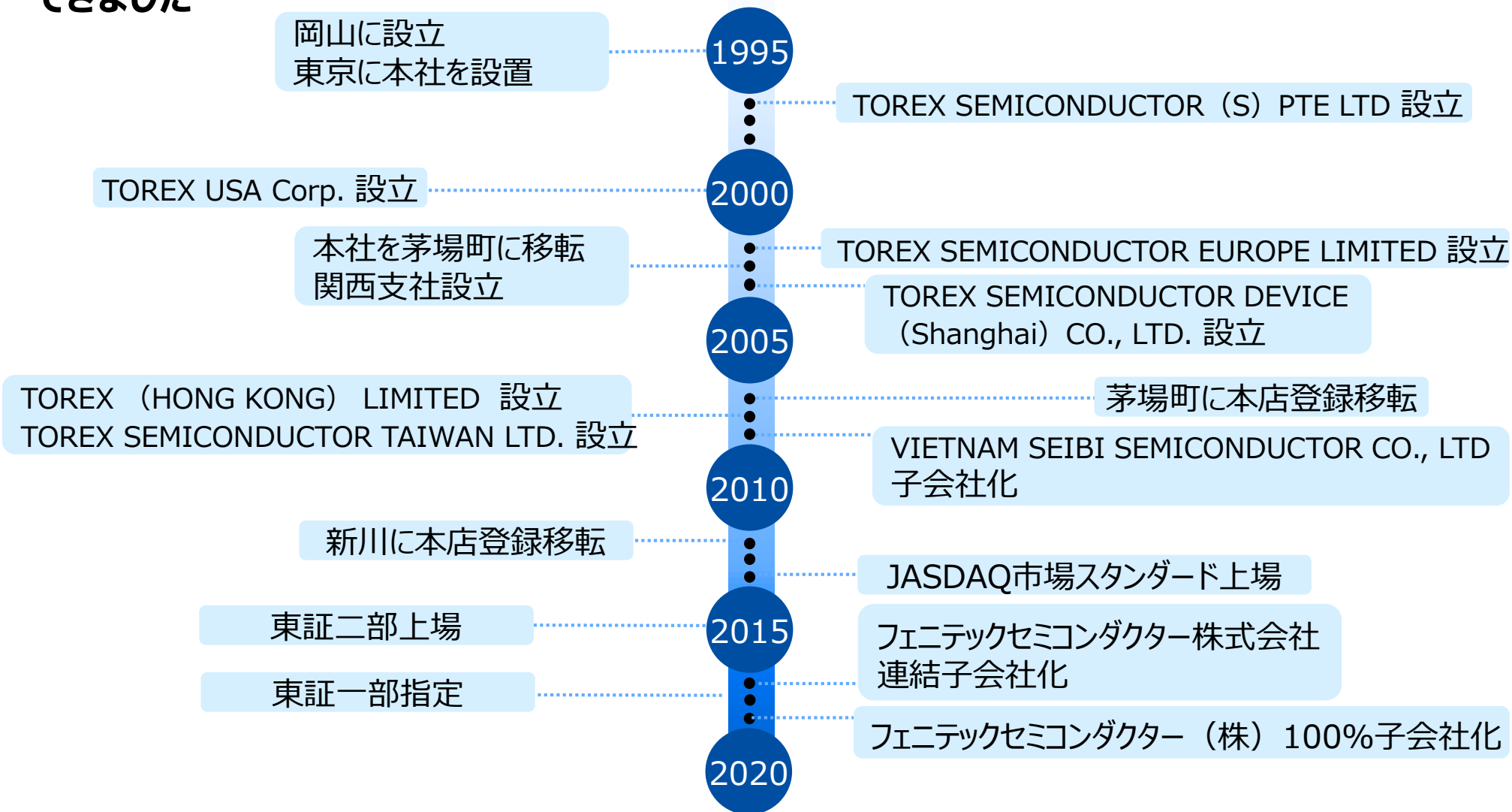
ABOUT TOREX

所在地	東京都中央区新川1-24-1 エゾ新川永代通りビル
代表者	代表取締役会長 藤阪 知之 代表取締役社長 芝宮 孝司
資本金	29億6793万円（2020年3月31日現在）
事業内容	1.半導体デバイスの開発、設計製造 2.半導体デバイスの販売
従業員数	当社：172名 / グループ：1,016名
上場証券取引所 及び上場日	東京証券取引所 市場第一部 2018年3月22日
単元株式数	100株
決算期	3月末日
証券コード	6616
URL	https://www.torex.co.jp/

常に豊かな知性と感性を磨き、市場に適応した価値ある製品を創出し、豊かな社会の実現と地球環境の保全に貢献するとともに、私たちの事業に携わるすべての人々が共に繁栄することを企業の理念とする。

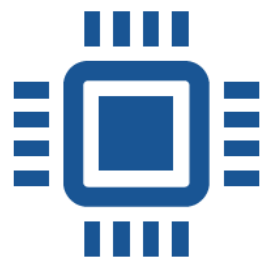


●電源IC一筋、**省電力・小型化**の技術でエレクトロニクス産業技術の発展に貢献してきました



トレックス・セミコンダクター

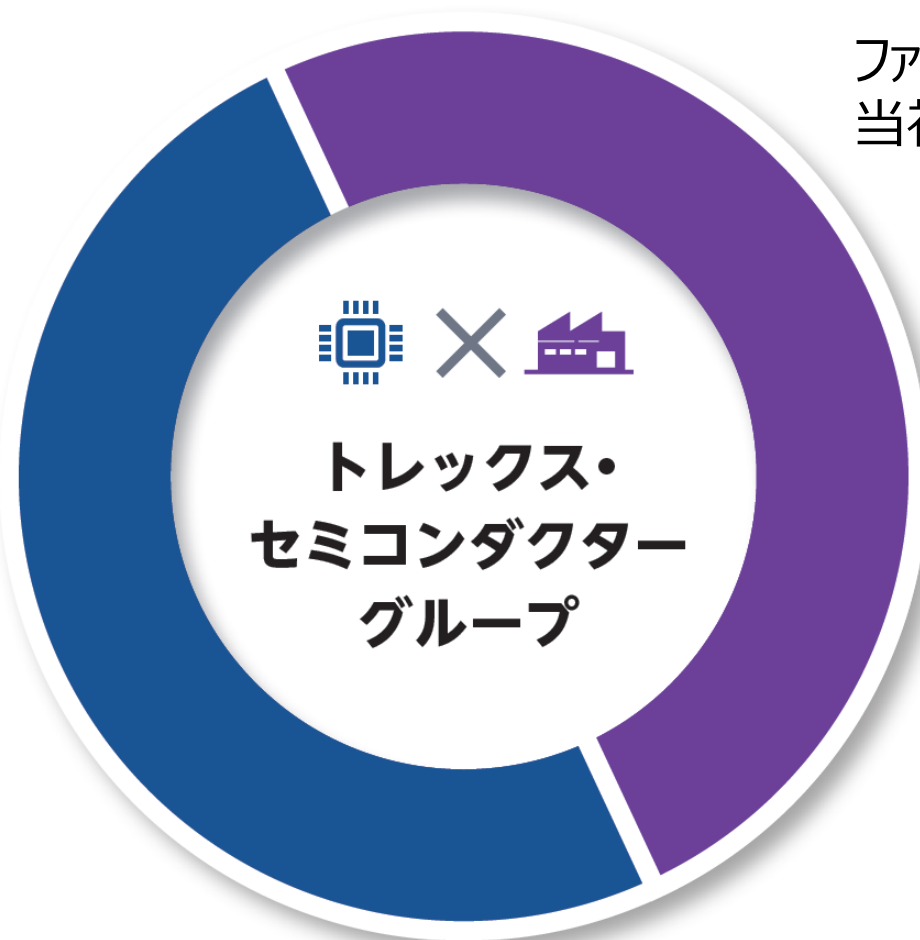
超小型・省電力
電源ICの開発・販売



フェニテックセミコンダクター

ファンドリー（半導体受託製造）
当社出資比率100%

Phenitec
For Further Growth Together



※ファンドリー：顧客から半導体の製造工程を受託し、顧客の設計データに基づいて半導体を製造する会社

- 国内に東京本社を含む 8 拠点、海外に9つの拠点を設け、世界の需要に対応しています。



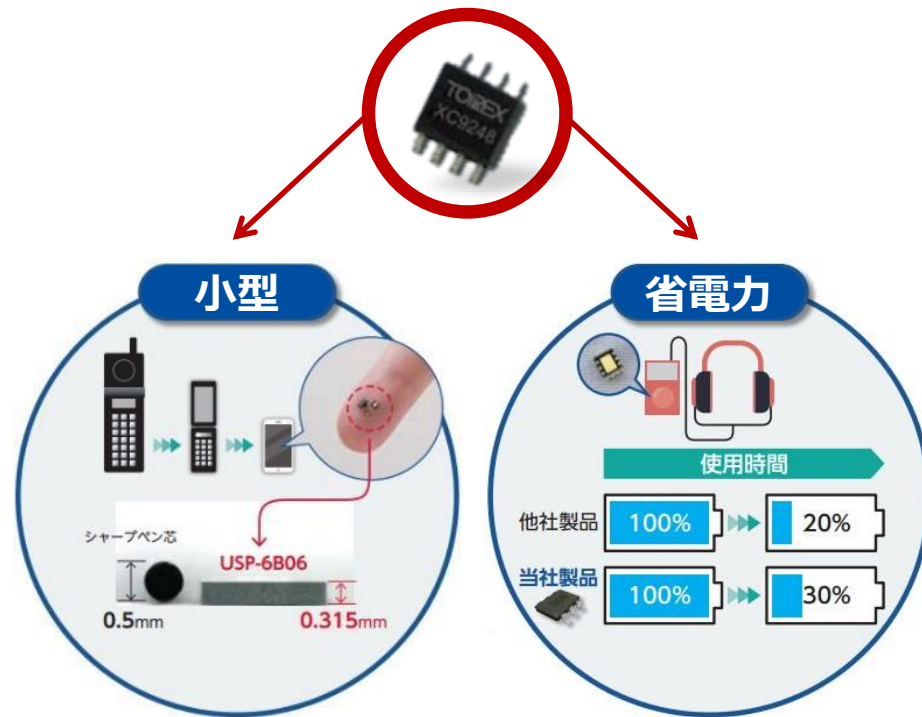
- 世界トップクラスの小型・省電力電源ICを開発・販売しています。

電源ICの役割



電子機器の様々な機能を動かすために
電圧を制御し安定供給する

TOIREXの電源IC



独自の技術で電子機器の
小型化、省電力化に貢献

- フェニテックセミコンダクターは、国内唯一の半導体受託製造専門メーカーです。

前工程(ファンドリーサービス)				
生産				部分加工
自社開発品 =オリジナル製品		生産受託品 =カスタム製品		生産受託品 =カスタム製品
既存製品を提案/提供	お客様の要望にあわせてカスタム製品を開発/提供	自社保有のプロセスを利用しお客様設計製品を生産	お客様からプロセスと設計を移管していただき、お客様製品を生産	ウェハー生産の一部を加工処理

お客様のニーズに基づいたファンドリーソリューションを提供することで低コスト・高品質の製品を実現

提供する製品

ディスクリート
1つの機能だけ備えた単機能半導体
半導体業界の“ねじ”と“くぎ”のような存在

その中でも、**パワー半導体**を中心とした
高品質・高付加価値の製品を提供

主なディスクリート製品

ダイオード	交流を直流に変換したり、逆流を防ぐなど、電気の流れを整える部品。
トランジスタ	電気を流したり、止めたりするなど、電気の流れをコントロールする部品。
IGBT	電力制御の用途で使用される部品 パワー半導体分野のトランジスタ分野に分類される。

※ファンドリー：顧客から半導体の製造工程を受託し、顧客の設計データに基づいて半導体を製造する会社

本資料に記載された内容は、2020年5月21日現在において一般的に入手可能な情報と、合理的と判断する一定の前提に基づき、当社が作成したものです。

本資料に記載されている当社の中期計画、見通し等に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。

実際の業績は、これらの要素により本資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。

投資に関するご決定をされる際、本資料のみに全面的に依拠することはお控えいただき、みなさまご自身のご判断でなされるようお願い致します。

Powerfully Small!

常に豊かな知性と感性を磨き、
市場に適応した価値ある製品を創出し、
豊かな社会の実現と
地球環境の保全に貢献するとともに、
私たちの事業に携わるすべての人々が
共に繁栄すること

